

用户名 密 码 [注册](#) | [忘记密码?](#) | [FAQ](#)论文快速检索 [高级检索](#)[首页](#)[期刊介绍](#) ▼[编委介绍](#)[投稿须知](#)[读者服务](#) ▼[链接](#)[联系我们](#)[English](#)

金属学报 » 2013, Vol. 49 » Issue (3): 341-350 DOI: 10.3724/SP.J.1037.2012.00636

[论文](#)[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)[◀◀ 前一篇](#) | [后一篇 ▶▶](#)

BGA结构Sn-3.0Ag-0.5Cu/Cu焊点低温回流时界面反应和IMC生长行为

周敏波, 马骁, 张新平

华南理工大学材料科学与工程学院, 广州 510640

THE INTERFACIAL REACTION AND INTERMETALLIC COMPOUND GROWTH BEHAVIOR OF BGA STRUCTURE -3.0Ag-0.5Cu/Cu SOLDER JOINT AT LOW REFLOW TEMPERATURES

ZHOU Minbo, MA Xiao, ZHANG Xinping

School of Materials Science and Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510640

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献](#)[相关文章 \(15\)](#)

版权所有 © 2008 《金属学报》编辑部

地址: 沈阳市文化路72号, 中国科学院金属研究所(110016)

电话: +86-024-23971286, 传真: +86-024-23843760 E-mail: jsxb@imr.ac.cn

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn